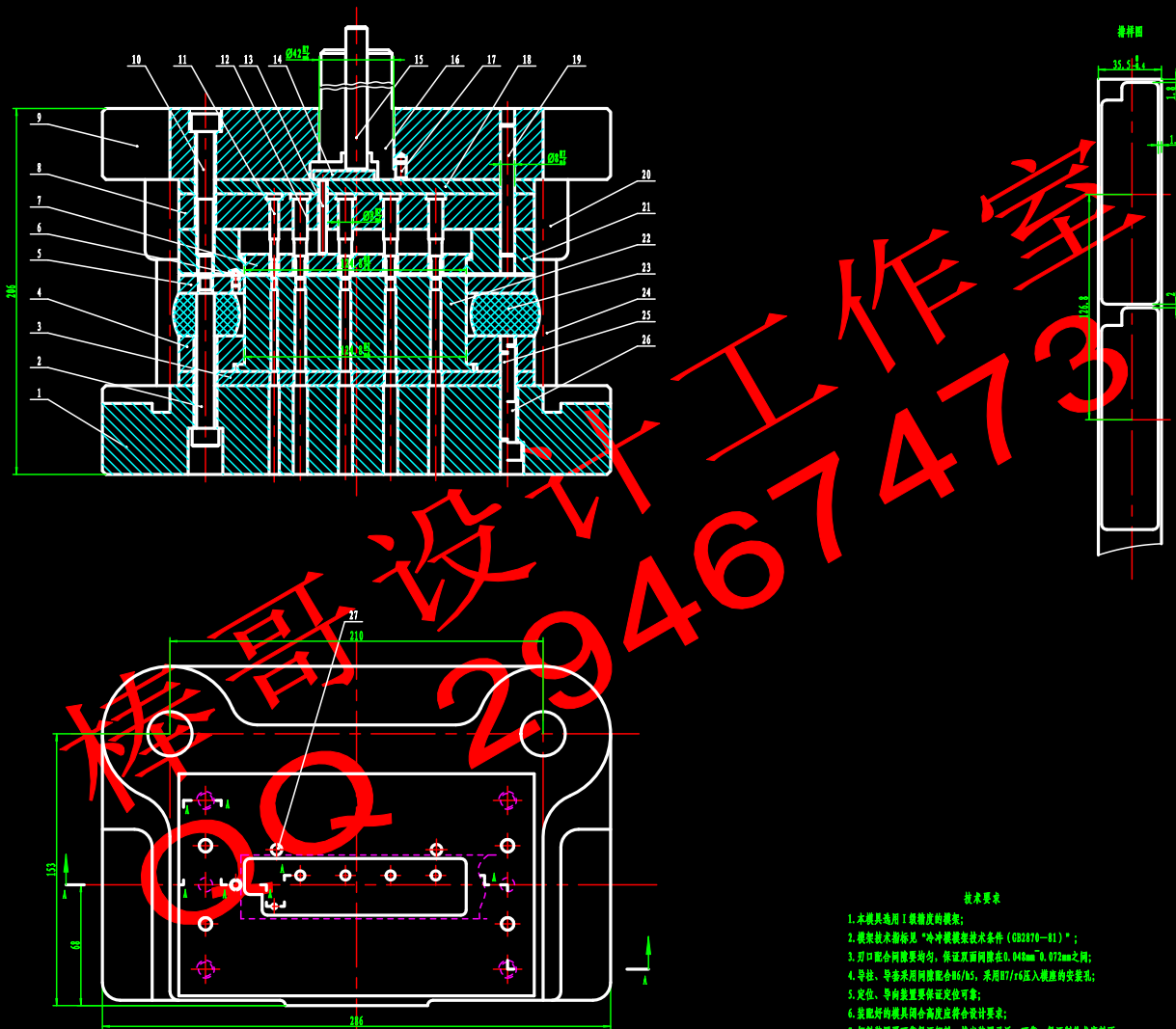


AO-落料冲孔复合模装配图



技术要求

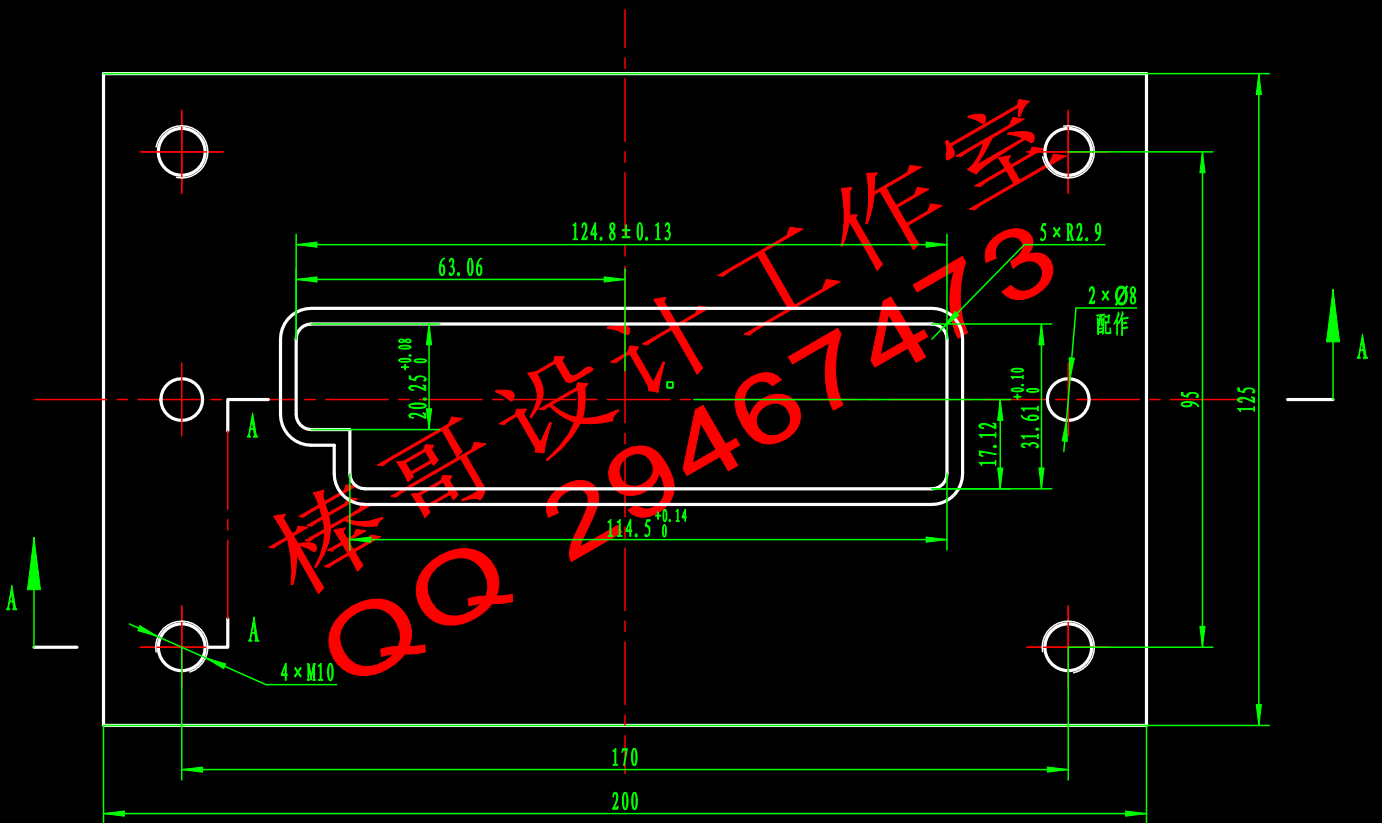
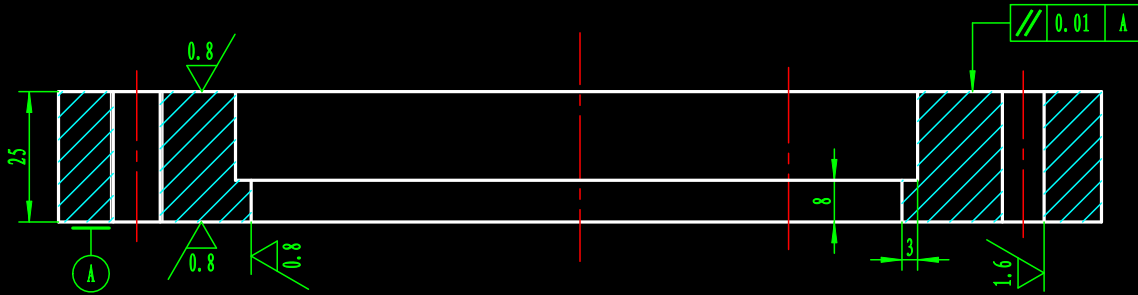
1. 本模具选用 I 级精度的模架;
2. 模架技术要求见“冷冲模模架技术条件 (GB2870-81)”;
3. 刃口配合间隙要均匀, 保证两面间隙在 0.04mm~0.07mm 之间;
4. 导柱、导套采用间隙配合 H6/h5, 采用 H7/r6 压入模座的安装孔;
5. 定位、导向装置要保证定位可靠;
6. 装配好的模具闭合高度应符合设计要求;
7. 卸料装置要可靠保证卸料, 推出装置灵活、可靠, 保证制件或废料不卡在型腔孔内;
8. 工作表面粗糙度不得大于 0.02。

代号	规格	名称	数量	材料	热处理	备注
231		上模座	2	HT12		HTC 52 56
23	GH70-85	M10×55 防沾漏螺钉	4	HT215		HTC 43 48
23	GH115-85	8×50 顶柱	2	45		HTC 43 48
23	GH2861, L=81	72.5×5×180 导柱	2	20		镀层镀文
23		导套	2	HT215		
23		导套	4	HT215		
23		导套	1	HT215		HTC 43 48
23		导套	1	HT215		HTC 43 48
20	GH2861, L=81	72.5×6×85×33 导套	2	20		镀层镀文
13	GH115-85	8×74 顶柱	2	45		HTC 43 48
13		顶柱	1	HT215		HTC 43 48
13	GH115-85	8×10 顶柱	1	45		HTC 43 48
13	GH2872, L=81	120×110 导柱	1	HT215		HTC 43 48
13	GH2872, L=81	112×110 导柱	1	HT215		HTC 43 48
13		导套	1	45		HTC 43 48
13		导套	1	45		HTC 43 48
13		导套	1	45		HTC 43 48
13		导套	1	HT215		HTC 43 48
13		导套	1	HT215		HTC 43 48
10	GH70-85	M10×70 防沾漏螺钉	4	HT215		HTC 43 48
9	GH2855, L=200	110×125×40 上模座	1	HT120		HTC 43 48
8		下模座	1	HT120		HTC 43 48
8		导套	1	HT120		HTC 43 48
6	GH2872, L=81	116×4×32 导柱	4	45		HTC 43 48
5		导套	1	HT120		HTC 43 48
5		导套	1	HT120		HTC 43 48
3		导套	1	HT215		HTC 43 48
2	GH2872, L=81	110×75 导柱	4	45		HTC 43 48
1	GH2855, L=200	110×125×40 下模座	1	HT120		HTC 43 48

A3-凹模

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A



技术要求

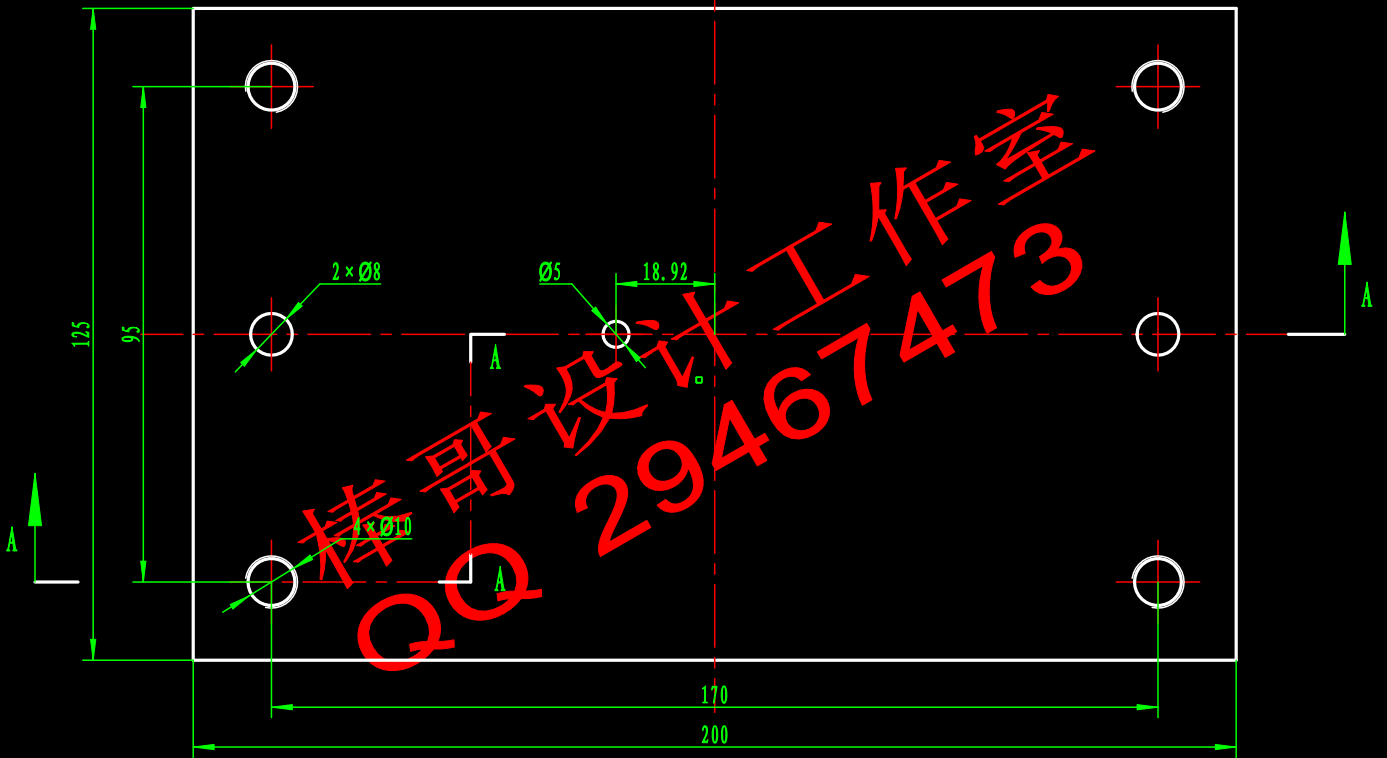
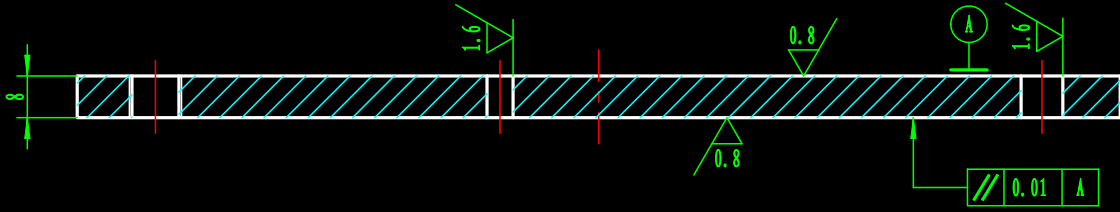
1. 热处理：淬火、回火，硬度60~62HRC。
2. 导料销与凹模配合的让孔图中为标出，根据实际尺寸配作。

					Cr12MoV			桂林电子科技大学	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			凹模	
设计	覃珊	2014-3-27	标准化			阶段标记	重量	比例	004
审核								1:1	
工艺			批准			共	张	第	张

A3-垫板1

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A



技术要求

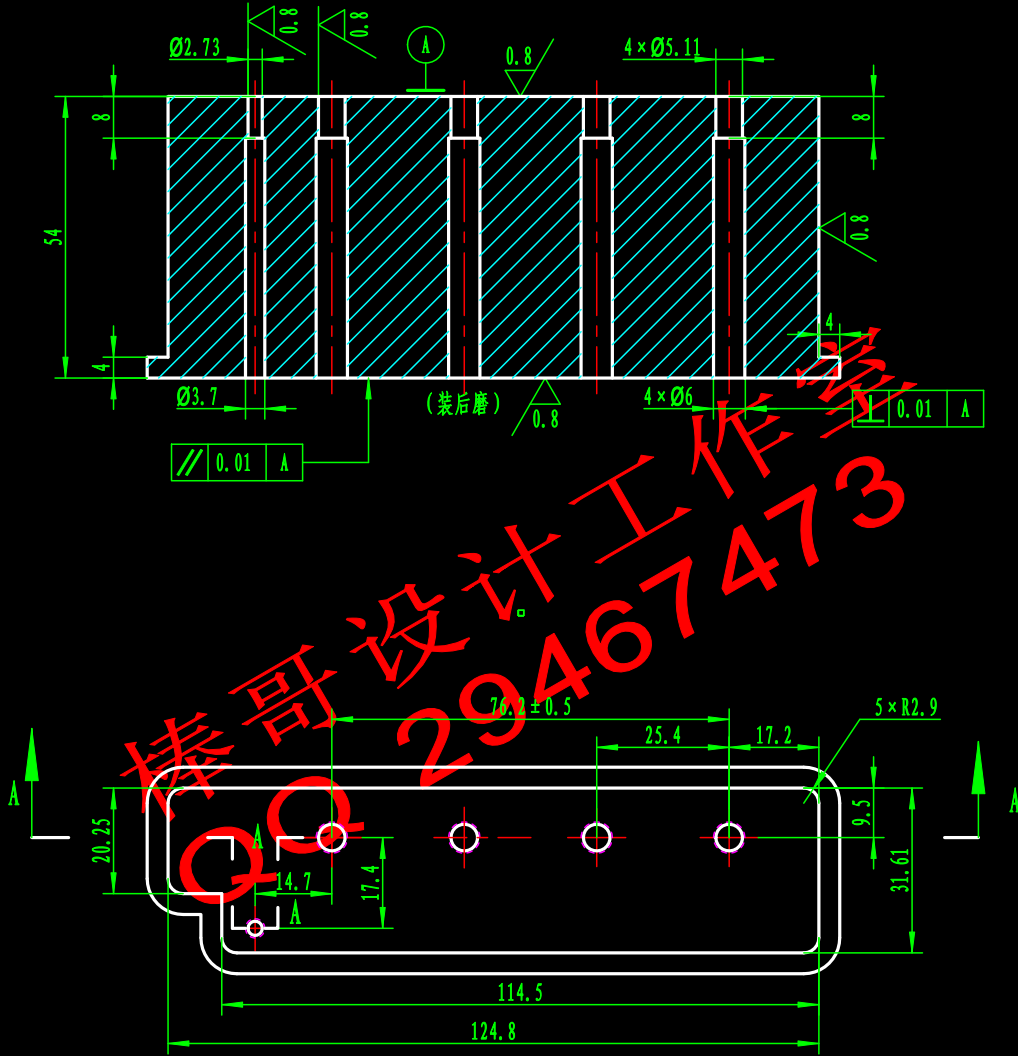
1. 热处理: 淬火、回火, 硬度43~48HRC;
2. 两Ø8销孔与上模座配作。

					Q275			桂林电子科技大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			垫板1
设计	覃珊	2014-4-27	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第
								张
								005

A3-凸凹模

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A



技术要求

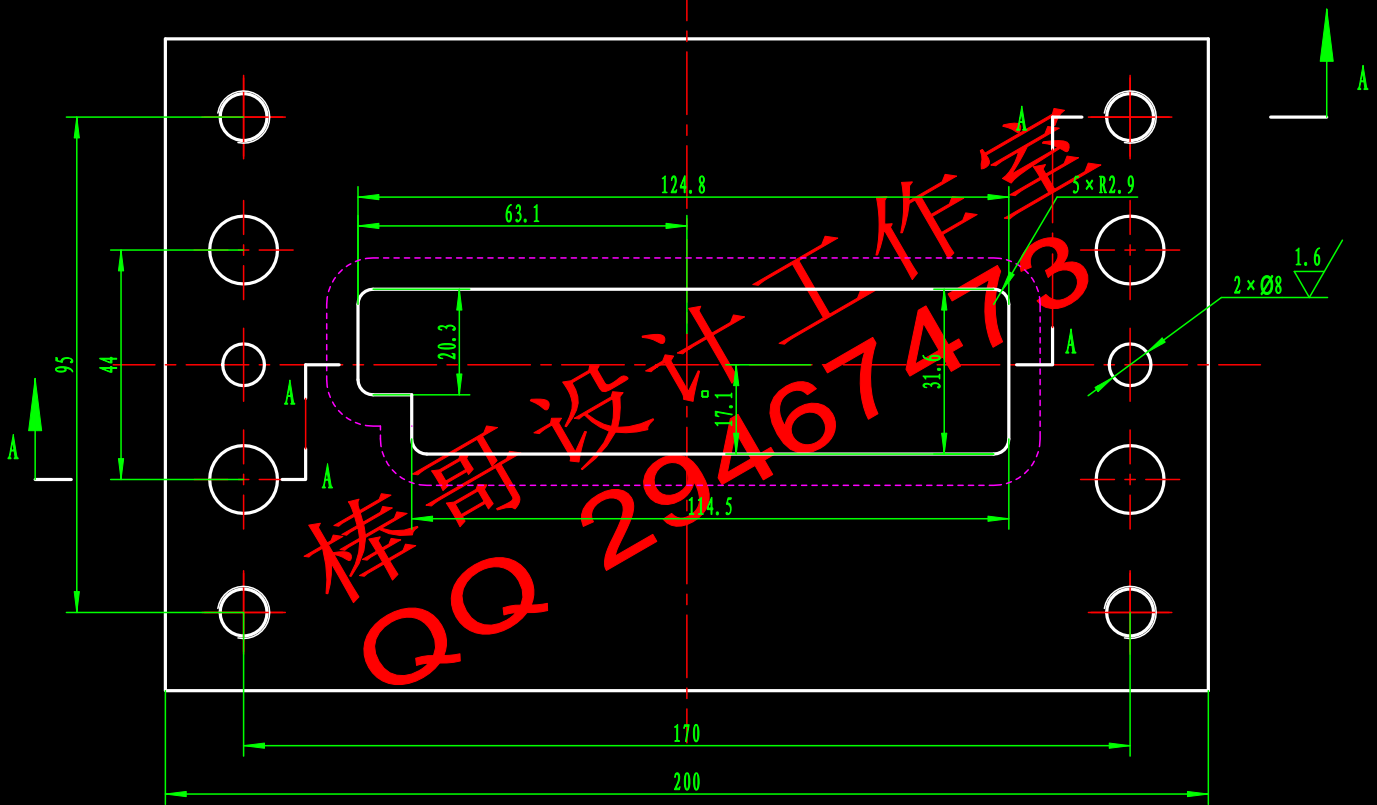
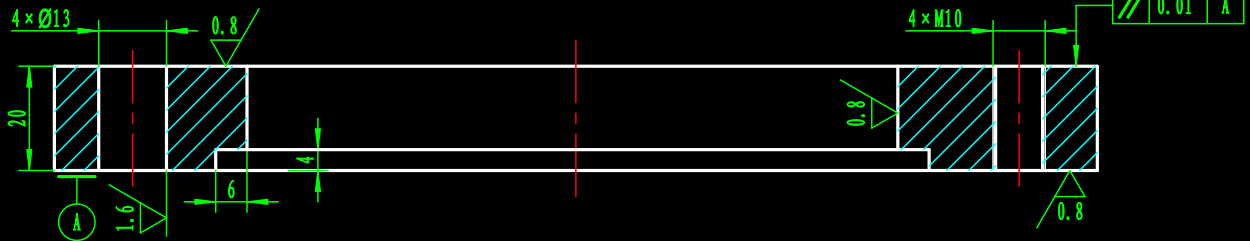
1. 热处理: 淬火、回火, 硬度 $60\sim 62\text{HRC}$;
2. 按凸、凹模的实际尺寸间隙配作, 保证双面间隙在 $0.048\text{mm}\sim 0.072\text{mm}$ 之间。

					Cr12MoV			桂林电子科技大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			凸凹模
设计	覃珊	2014-3-25	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第
								张
								007

A3-凸凹模固定板

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A

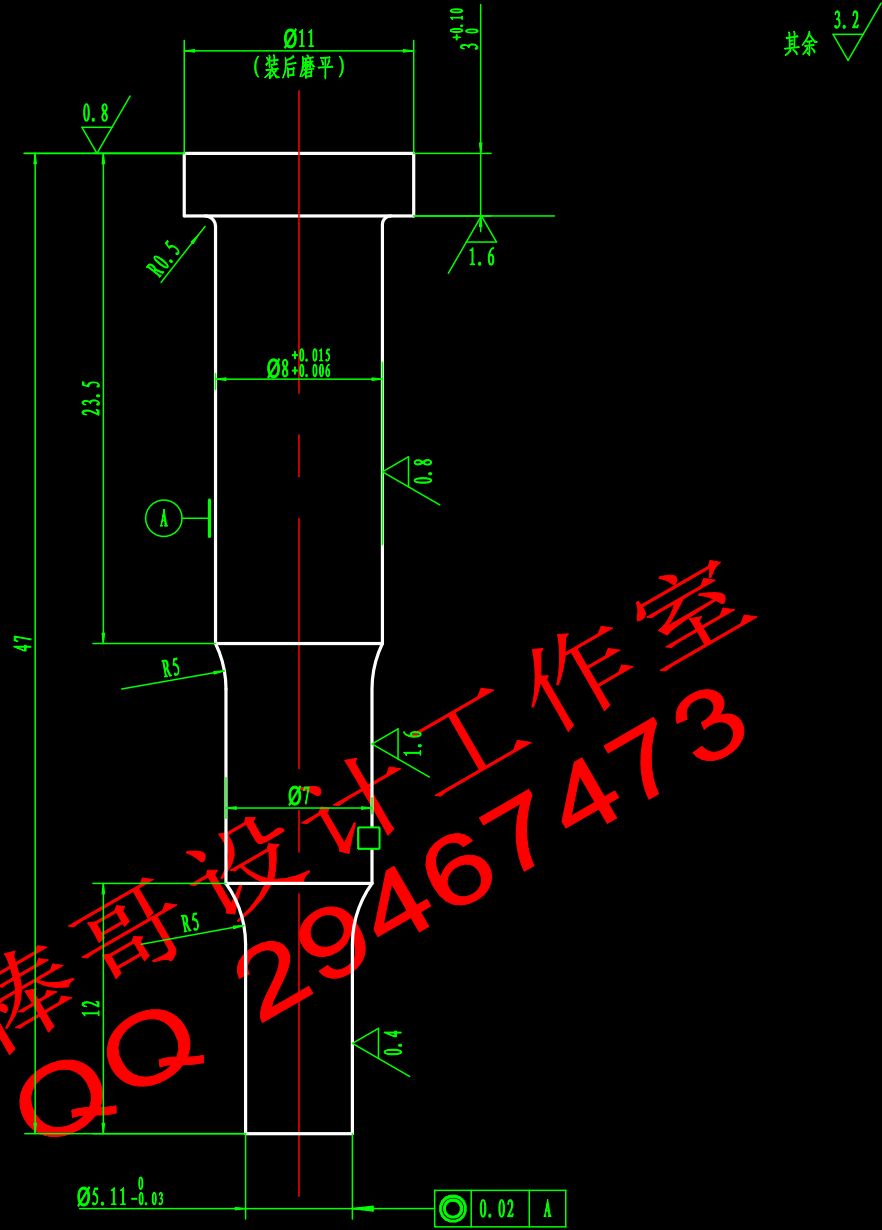


技术要求

1. 在正确的对好冲孔间隙后，两Ø8销钉孔与下模座配合。

						Cr12			桂林电子科技大学	
									凸凹模固定板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	011
设计	覃珊	2014-4-25	标准化						1:1	
审核						共 张		第 张		
工艺			批准							

A3-凸模2



技术要求

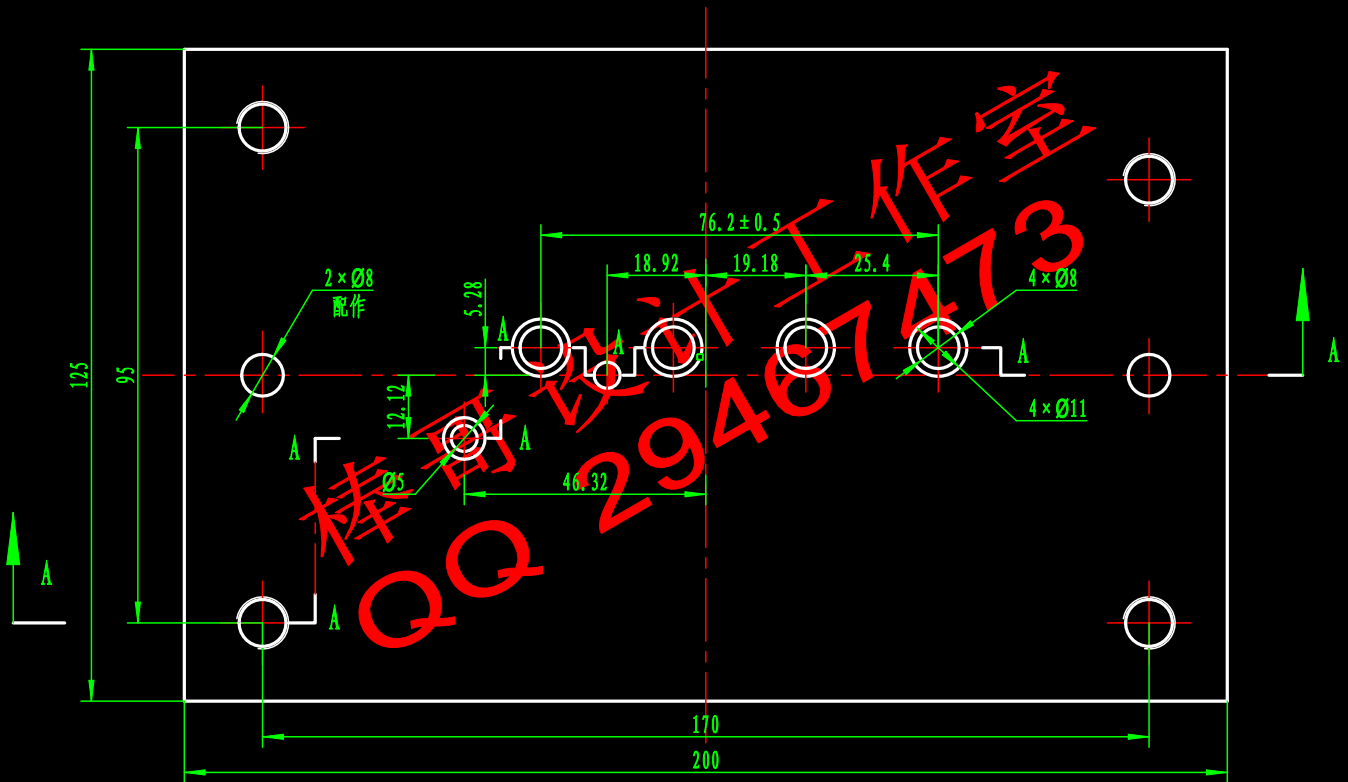
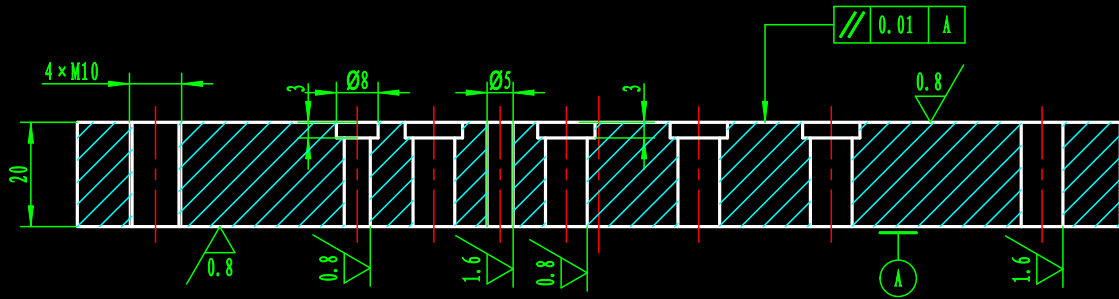
1. 热处理: 淬火、回火, 硬度58~62HRC.

						Cr12MoV			桂林电子科技大学	
									凸模2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	003
设计	覃珊	2014-3-27	标准化						4:1	
审核						共		张	第	张
工艺			批准							

A3-凸模固定板

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A

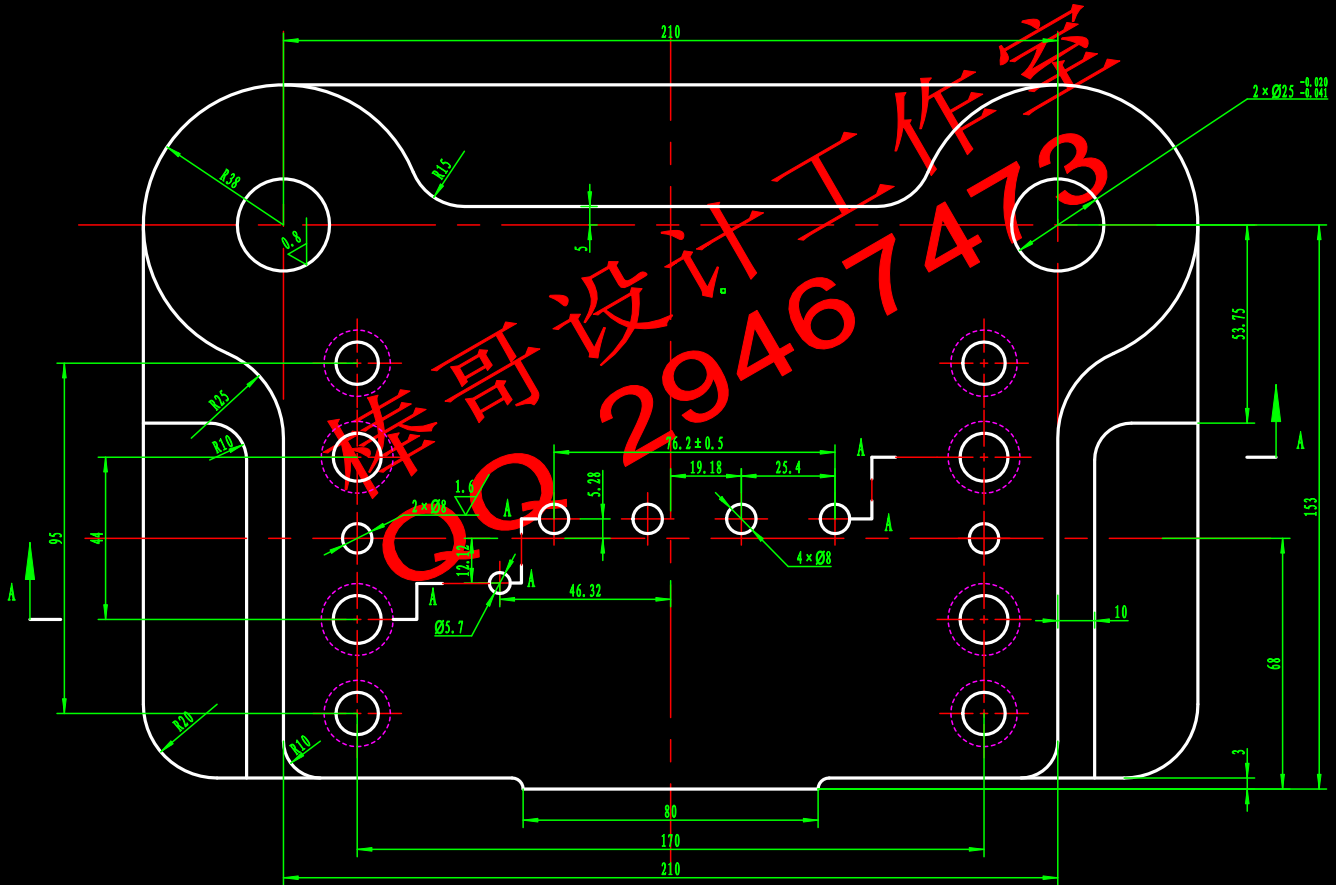
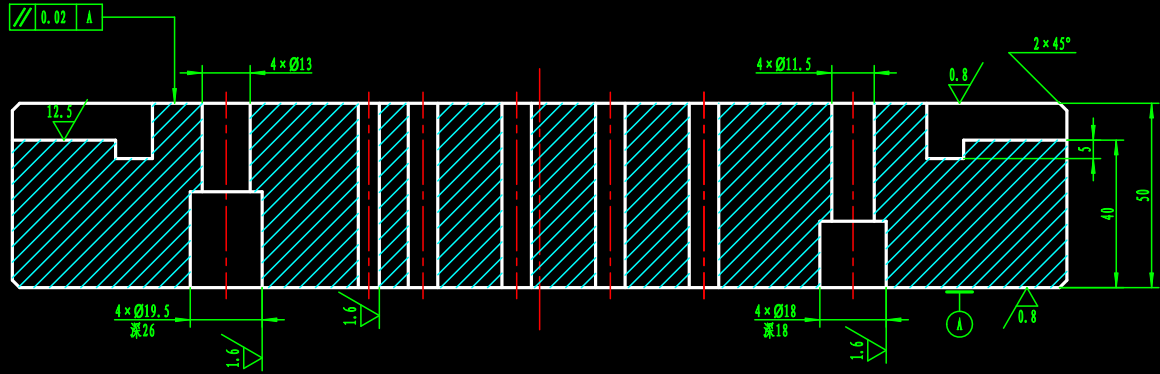


					Cr12			桂林电子科技大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			凸模固定板
设计	覃珊	2014-4-27	标准化			阶段标记	重量	比例
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第
								张
								008

A3-下模座1

其余 $\sqrt{6.3}$

A-A



技术要求

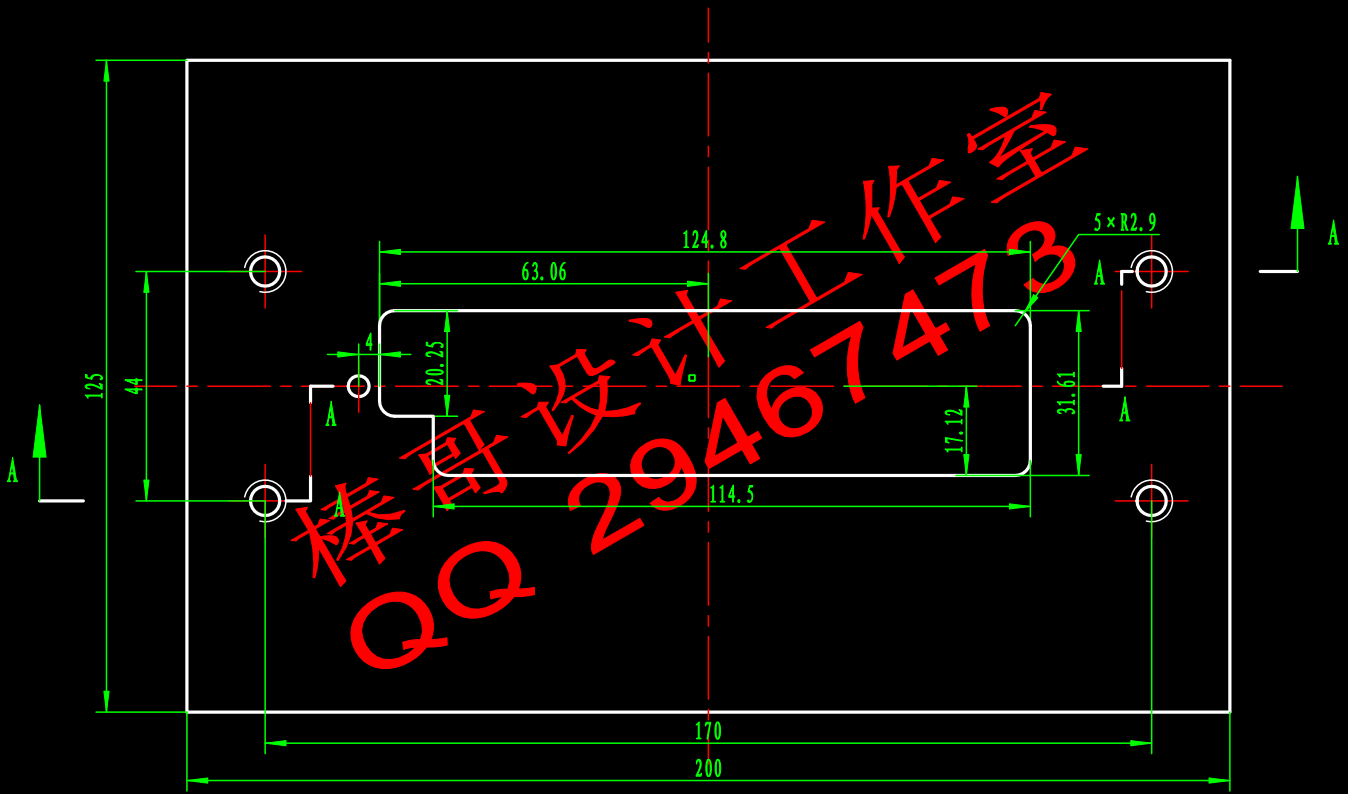
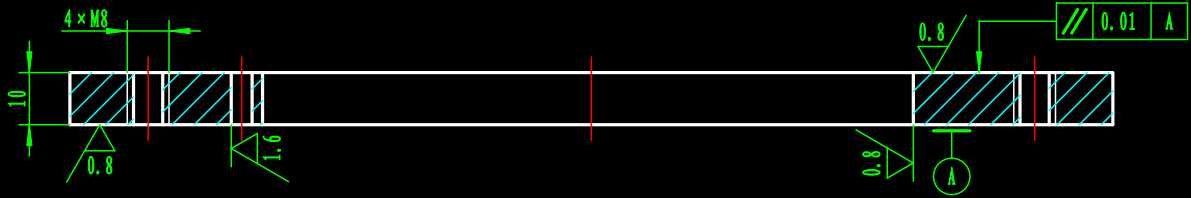
1. 热处理: 时效;
2. 2个 $\Phi 8$ 铆钉孔与下模座配作。

					HT200			桂林电子科技大学	
								下模座2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量	比例	
设计	覃珊	2014-4-25	标准化					1:1	
审核								010	
工艺						共	张	第	张

A3-卸料板

其余 $\sqrt{3.2}$

A-A



技术要求

1. 热处理：淬火，硬度43~48HRC；

						Cr12			桂林电子科技大学	
									卸料板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	009
设计	覃珊	2014-4-25	标准化						1:1	
审核						共 张		第 张		
工艺			批准							